

权 利 要 求

- 1.一种封装基板，包括：
本体，所述本体包括开口区域；
5 导电层，所述导电层设置于所述开口区域，所述导电层包括第一导电桥和第二导电桥，
所述第一导电桥和所述第二导电桥间隔设置；
其中，所述第一导电桥上设置有第一通孔。
- 2.根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述第一通孔为多个，多个所述第一通孔
间隔地设置在所述第一导电桥上。
- 10 3.根据权利要求2所述的封装基板，其中，多个所述第一通孔沿所述第一导电桥的长
度方向间隔设置。
- 4.根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述第一导电桥和所述第二导电桥之间形
成间隙。
- 5.根据权利要求4所述的封装基板，其中，所述间隙内填充有导热部。
- 15 6.根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述第一通孔的孔壁包括弧面和平面中的
至少之一。
- 7.根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述第二导电桥上设置有第二通孔。
- 8.根据权利要求7所述的封装基板，其中，所述第二通孔为多个。
- 9.根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述导电层还包括：
20 第三导电桥，所述第三导电桥与所述第一导电桥间隔设置，所述第三导电桥与所述第
二导电桥间隔设置。
- 10.根据权利要求9所述的封装基板，其中，所述第三导电桥上设置有第三通孔。
- 11.根据权利要求9所述的封装基板，其中，所述第一导电桥、所述第二导电桥以及所
述第三导电桥沿所述开口区域的长度方向间隔设置。
- 25 12.根据权利要求11所述的封装基板，其中，所述第一导电桥与所述第二导电桥之间
的间距等于所述第二导电桥与所述第三导电桥之间的间距。
- 13.根据权利要求10所述的封装基板，其中，所述第三通孔为多个。
- 14.根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述第一导电桥为矩形结构。
- 15.根据权利要求1所述的封装基板，其中，所述第一导电桥包括：
30 第一桥接段，所述第一桥接段的两端均连接所述本体；

第二桥接段，所述第二桥接段的两端均连接所述本体，所述第一桥接段和所述第二桥接段间隔设置；

第三桥接段，所述第三桥接段的两端分别连接所述第一桥接段和所述第二桥接段；

其中，所述第一桥接段、所述第二桥接段以及所述第三桥接段中的至少之一上设置有
5 所述第一通孔。

16.根据权利要求 1 所述的封装基板，其中，所述第一导电桥包括：

第一桥接段，所述第一桥接段的一端连接所述本体；

第二桥接段，所述第二桥接段的一端连接所述本体；

第三桥接段，所述第三桥接段的一端连接所述第一桥接段的另一端，所述第三桥接段
10 的一端连接所述第二桥接段的另一端，所述第三桥接段的另一端连接所述本体；

其中，所述第一桥接段、所述第二桥接段以及所述第三桥接段中的至少之一上设置有
所述第一通孔。

17.根据权利要求 15 或 16 所述的封装基板，其中，所述第一桥接段、所述第二桥接段
以及所述第三桥接段是一体成型结构。

15 18.根据权利要求 1 所述的封装基板，其中，所述封装基板还包括：

导电凸点，所述导电凸点设置在所述本体上，且位于所述开口区域的外侧；

其中，所述开口区域的上方和下方均具有所述导电凸点，所述开口区域的壁面位于所
述导电凸点之间。

19.根据权利要求 18 所述的封装基板，其中，所述壁面包括相对的两个第一壁面和相
20 对的两个第二壁面，所述第一壁面沿所述开口区域的宽度方向延伸，所述第二壁面沿所述
开口区域的长度方向延伸；

其中，最外侧的上下两个所述导电凸点的外边缘的连线围成限位区域，所述第一壁面
位于所述限位区域内。

20.一种半导体结构，包括权利要求 1 至 19 中任一项所述的封装基板和芯片。
25